2027年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年11月13日

上場会社名　竹田ｉＰホールディングス株式会社　上場取引所　東 名

コード番号　7875　ＵＲＬ　https://www.takedaip-hd.co.jp

代表者　（役職名）代表取締役社長 COO　（氏名）細野　浩之

問合せ先責任者　（役職名）上席執行役員 CFO 経営統括本部長　（氏名）巻尾　忠臣　ＴＥＬ　052-871-6351

半期報告書提出予定日　2026年11月13日　配当支払開始予定日　2026年12月１日

決算補足説明資料作成の有無：有

決算説明会開催の有無　：無

（百万円未満切捨て）

１．2027年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2026年４月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）　（%表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年３月期中間期	17,041	7.2	572	26.4	582	14.0	656	53.8
2026年３月期中間期	15,903	△1.6	453	5.6	510	6.6	427	46.4

（注）包括利益　2027年３月期中間期　973百万円（61.9%）　2026年３月期中間期　601百万円（－%）

	１株当たり中間純利益	潜在株式調整後１株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年３月期中間期	39.42	－
2026年３月期中間期	25.61	－

（注）当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり中間純利益」を算定しております。

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	１株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2027年３月期中間期	39,023	20,412	51.9	1,238.17
2026年３月期	34,654	19,998	57.3	1,187.40

（参考）自己資本　2027年３月期中間期　20,272百万円　2026年３月期　19,857百万円

（注）当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年３月期	－	14.00	－	33.00	47.00
2027年３月期	－	10.00			
2027年３月期（予想）			－	16.50	26.50

（注）当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2026年３月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2027年３月期及び2027年３月期（予想）については、当該株式分割後の数値を記載しております。

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

2027年３月期における１株当たり中間配当金については、７円から10円に変更しております。詳細につきましては、本日（2026年11月13日）公表いたしました「剰余金の配当（中間配当・増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

３．2027年３月期の連結業績予想（2026年４月１日～2027年３月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	36,000	4.4	1,630	25.1	1,624	11.6	1,450	30.1	87.78

（注）当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。2027年３月期の連結業績予想における「１株当たり当期純利益」については、当該株式分割の影響を考慮しております。

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※　注記事項

（１）当中間期における連結範囲の重要な変更：有

新規　1社　（社名）大英エレクトロニクス株式会社、除外　－社　（社名）－

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料Ｐ.10「２．中間連結財務諸表及び主な注記（４）中間連結財務諸表に関する注記事項（中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更	：無
②　①以外の会計方針の変更	：無
③　会計上の見積りの変更	：無
④　修正再表示	：無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2027年３月期中間期	17,562,000株	2026年３月期	17,562,000株
②　期末自己株式数	2027年３月期中間期	1,189,142株	2026年３月期	838,642株
③　期中平均株式数（中間期）	2027年３月期中間期	16,662,172株	2026年３月期中間期	16,671,777株

（注）当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算出しております。

※　第２四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．５「１.経営成績等の概況（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 …… 2
（１）当中間期の経営成績の概況 …… 2
（２）当中間期の財政状態の概況 …… 4
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 5
２．中間連結財務諸表及び主な注記 …… 6
（１）中間連結貸借対照表 …… 6
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …… 8
中間連結損益計算書 …… 8
中間連結包括利益計算書 …… 8
（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書 …… 9
（４）中間連結財務諸表に関する注記事項 …… 10
（中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記） …… 10
（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記） …… 10
（セグメント情報等の注記） …… 11
（企業結合等関係） …… 13
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 15
（継続企業の前提に関する注記） …… 15
（重要な後発事象） …… 15

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方、中東情勢をはじめとする地政学的リスクや米国の通商政策の動向、原材料・エネルギー価格及び為替相場の変動などにより、先行きは依然として不透明な状況が続きました。

当社グループを取り巻く事業環境においては、印刷市場の構造的な縮小に加え、原材料費、物流費及び人件費等の上昇に対応した価格改定と生産性の向上が引き続き課題となりました。一方、半導体関連分野では、ＡＩ関連投資などを背景とした需要の拡大に対応するため、製品分野ごとの需要動向を見極めながら、受注の確保及び供給体制の強化に取り組みました。

このような経営環境のもと、当社グループは、2024年度から2026年度までを対象とする中期経営計画「Takeda ｉＰ Create a Value Project」の最終年度を迎え、既存事業の収益力強化及び事業構造改革を進めるとともに、半導体関連マスク、ＢＰＯ・ＤＸ及びグローバルパッケージなどの成長分野に経営資源を配分し、事業ポートフォリオの変革に取り組みました。

半導体関連分野における事業領域の拡大を目的として、2026年７月13日付で大英エレクトロニクス株式会社の株式を取得し、同社を完全子会社化しました。当第２四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含め、プリント基板のレイアウト設計、基板電気検査及び３Ｄ－ＭＩＤレイアウト設計サービスの分野で、グループの事業機能を拡充しました。同社の人材・技術・顧客基盤を生かし、既存の半導体関連マスク事業との連携を通じて、提案領域の拡大と顧客ニーズへの対応力向上を図ってまいります。

また、グループ本社移転を目的として、2026年７月３日に土地及び建物の取得を完了しました。新社屋取得及び大英エレクトロニクス株式会社の株式取得等に要する資金については、金融機関からの借入れを活用しました。

あわせて、政策保有株式及び低稼働資産の売却を進め、得られた資金を半導体関連マスク事業などの成長分野への投資等に充てております。こうした資産の入替えと借入れの活用を通じて、財務健全性に配慮しながら、中長期的な収益力と資本効率の向上を図ってまいります。

株主還元の充実に向けては、機動的な資本政策の一環として、2026年８月26日に自己株式417,400株を337百万円で取得しました。

投資環境の整備については、投資家層の拡大及び市場流動性の向上を図るため、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しました。

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は17,041百万円（前年同期比7.2%増）となりました。このうち、海外売上高は1,792百万円（前年同期比3.3%増）、海外売上高比率は10.5%（前年同期は10.9%）となりました。営業利益は、半導体関連マスク事業の伸長などにより、572百万円（前年同期比26.4%増）となりました。経常利益は、支払利息の増加や為替差損の計上があったものの、582百万円（前年同期比14.0%増）となりました。親会社株主に帰属する中間純利益は、政策保有株式及び低稼働資産の売却に伴う特別利益の計上などにより、656百万円（前年同期比53.8%増）となりました。

セグメント別の状況は、以下のとおりです。

（情報コミュニケーション）

商業印刷分野では、印刷案件の減少や一部案件の計上時期のずれが売上高に影響したほか、生産量の不足やエネルギー費の上昇により、厳しい収益環境が続きました。既存顧客への提案強化や新規顧客の開拓により受注確保に努めるとともに、価格改定及び高付加価値案件の獲得を進めましたが、コスト上昇分の価格転嫁や生産効率の向上には課題が残りました。

こうしたなか、国内のパッケージ分野では受注が増加し、増収増益に寄与しました。また、ＢＰＯ・ロジスティクス分野では物流業務が堅調に推移し、パッケージ分野の伸長とともにセグメント全体の業績を支えました。受発注管理システム「ＴＳ－ＢＡＳＥ」の新規導入や既存顧客への追加提案、物流業務や事務局運営等の受託拡大を進め、システム開発やプロモーション支援の機能も組み合わせて取引領域の拡大を図りました。

生産・物流体制の整備では、2026年８月末にＴＳ－ＢＡＳＥ小牧２の業務をＴＳ－ＢＡＳＥ春日井へ集約し、物流業務の効率化を進めました。

海外では、中国において、収益性を重視した低採算案件の見直しを進めたことにより、売上高が減少しました。タイのパッケージ事業では、米国の関税政策を受けた顧客の発注見直しにより受注が減少しましたが、新工場の生

産体制の安定化と品質・生産効率の向上を進めるとともに、顧客開拓に取り組んでおり、今後は代替案件の受注拡大による回復を見込んでおります。パッケージ事業では、国内外の拠点の連携により、紙器・パッケージ分野の事業基盤を強化しております。

以上の結果、情報コミュニケーションセグメントの売上高は7,528百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は35百万円（前年同期比22.8％増）となりました。

（ソリューションセールス）

ソリューションセールスは、印刷機材の総合商社である株式会社光文堂を中心に、顧客の設備投資需要と印刷資材の継続的な需要の双方に対応しております。全国の営業網と長年培ってきた技術・ノウハウを生かし、ＫＢＤブランド製品をはじめとする印刷機械・関連システムの販売、印刷資材の継続供給及び技術サポートを行っております。

当中間連結会計期間においては、各地で開催した展示会での製品紹介や実演を通じて、顧客の省力化、生産性向上及び印刷物の高付加価値化に向けた販売活動を展開しました。具体的には、小ロット・多品種生産に対応するデジタル印刷機、作業の自動化や色調の安定化に寄与する機器・システムなどの拡販に取り組むとともに、全国の営業拠点を通じて新規顧客や異業種の取引先の開拓を進めました。

資材販売が伸長し、売上高及び利益を支えました。外部顧客への売上高は前年同期比5.9％増加しましたが、前年同期のグループ内向け大型機械販売の反動などにより、セグメント間売上高が減少し、セグメント全体では減収となりました。利益面では、貸倒引当金繰入額等が増加し、販売費及び一般管理費の増加を通じて利益を押し下げました。

以上の結果、ソリューションセールスセグメントの売上高は5,971百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益は160百万円（前年同期比3.8％増）となりました。

（半導体関連マスク）

半導体関連マスクは、当社グループの中長期的な収益拡大と事業ポートフォリオの変革を担う中核事業です。スクリーンマスク、フォトマスク及びメタルマスクの各分野に対応する技術基盤を有し、顧客の用途や要求仕様に応じた製品・サービスを提供しております。

当中間連結会計期間においては、国内及び中国・東南アジアの拠点が連携し、半導体・電子部品向け製品の受注拡大、技術開発並びに生産性の向上に取り組みました。株式会社プロセス・ラボ・ミクロンでは、前連結会計年度に中部ＴＥＣの生産機能を川越ＴＥＣへ集約しました。当中間連結会計期間は、半導体向けめっきマスク等の需要に対応する生産体制の整備と、価格改定、内製化及び工程改善を進めました。竹田東京プロセスサービス株式会社では、製品分野ごとの需要及び採算を踏まえた営業活動を展開するとともに、前連結会計年度末に実施した湘南藤沢センターから北陸センター及びテクノセンターへの製造業務の集約を生かし、生産体制の強化と生産性の向上に取り組みました。海外拠点では、各地域の需要動向に対応した営業活動及び国内拠点との連携を進めました。

また、大英エレクトロニクス株式会社の新規連結により、基板設計における対応領域を広げるとともに、電気検査サービスを加え、顧客の多様な設計・検査ニーズに対応する体制を強化しました。グループ各社の技術及び顧客基盤を生かし、基板設計、マスク製造及び基板電気検査を組み合わせた提案力を高めてまいります。

既存事業では、国内でＡＩ関連需要を背景に半導体向けめっきマスク等の販売が伸長し、中国でも半導体向け製品の受注が増加しました。また、国内のスクリーンマスクも堅調に推移しました。利益面では、原材料費等の上昇があったものの、半導体向け製品の増収や生産拠点の集約に伴う固定費の削減などが寄与しました。

また、大英エレクトロニクス株式会社の2026年７月から９月までの業績を取り込んだことにより、連結売上高に223百万円、のれん償却後の連結営業利益に23百万円が寄与しました。この利益寄与額には、同社の株式取得に係る取得関連費用16百万円は含めておらず、当該費用は全社費用として計上しております。

（注）上記の利益寄与額は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定したのれん償却額に基づいております。

以上の結果、半導体関連マスクセグメントの売上高は3,725百万円（前年同期比25.0％増）、営業利益は388百万円（前年同期比40.6％増）となりました。

（不動産賃貸）
不動産賃貸では、当社グループが保有する土地及び建物等を連結子会社及び外部顧客に賃貸し、安定的な賃貸収入の確保と資産の有効活用に取り組んでおります。また、中長期的な賃貸収入の拡大に向けて、保有土地を活用し、介護事業者への賃貸を目的とした介護施設の建設を進めました。

以上の結果、不動産賃貸セグメントの売上高は356百万円（前年同期比8.8%減）、営業利益は207百万円（前年同期比1.4%減）となりました。外部顧客への売上高は前年同期比1.2%増加しましたが、セグメント間売上高の減少により、セグメント全体では減収となりました。

（２）当中間期の財政状態の概況
当中間連結会計期間末における総資産は39,023百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,369百万円増加しました。流動資産は14,462百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,224百万円減少しました。これは主として、棚卸資産が497百万円増加した一方、現金及び預金が872百万円、受取手形、売掛金及び電子記録債権が640百万円減少したことによるものです。
固定資産は24,561百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,593百万円増加しました。主な要因は、グループ本社移転を目的とした土地及び建物の取得（取得価額2,910百万円）、大英エレクトロニクス株式会社の新規連結に伴う固定資産の受入れ及びのれんの計上（当中間連結会計期間末残高1,502百万円）であります。また、政策保有株式の縮減に伴う一部売却を行ったものの、保有株式の時価変動などにより、投資有価証券は前連結会計年度末に比べ252百万円増加しました。このほか、建設仮勘定が308百万円、リース資産が518百万円増加しました。

負債は18,611百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,955百万円増加しました。主な要因は、新社屋取得、介護施設建設及び大英エレクトロニクス株式会社の株式取得等に対応した借入れ、同社の新規連結による負債の受入れ並びにリース債務の増加であります。短期借入金は5,419百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,689百万円増加しました。このうち、上記投資資金の一部として調達したブリッジローン（短期のつなぎ融資）の残高は2,289百万円であり、長期借入金への借換えを予定しております。

純資産は20,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ413百万円増加しました。これは主として、親会社株主に帰属する中間純利益656百万円の計上及びその他有価証券評価差額金291百万円の増加があった一方、剰余金の配当及び自己株式の取得があったことによるものです。この結果、自己資本比率は51.9%（前連結会計年度末は57.3%）となりました。

（キャッシュ・フローの状況）
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ841百万円減少し、5,094百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、668百万円の収入（前年同期は176百万円の収入）となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益1,032百万円に、減価償却費610百万円及びのれん償却額79百万円を加算し、投資有価証券売却益（純額）507百万円を控除したほか、売上債権の減少770百万円、棚卸資産の増加488百万円、仕入債務の減少650百万円及び法人税等の支払額214百万円などを反映したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、5,272百万円の支出（前年同期は957百万円の支出）となりました。これは主として、新社屋の取得及び介護施設の建設等に係る有形固定資産の取得による支出4,180百万円、連結の範囲の変更を伴う大英エレクトロニクス株式会社の株式取得による支出2,040百万円及び無形固定資産の取得による支出91百万円があった一方、投資有価証券の売却及び償還による収入680百万円、固定資産の売却による収入210百万円などがあったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,727百万円の収入（前年同期は123百万円の支出）となりました。これは主として、新社屋取得、介護施設の建設及び大英エレクトロニクス株式会社の株式取得等に対応した資金調達により、短期借入金が4,689百万円純増した一方、長期借入金の返済による支出148百万円、自己株式の取得による支出337百万円、配当金の支払額275百万円及びリース債務の返済による支出198百万円などがあったことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2027年３月期の通期連結業績予想については、2026年８月10日に公表した予想から変更はありません。

配当につきましては、中間配当を前回予想の１株当たり７円から10円へ増額いたしました。期末配当予想は１株当たり16円50銭を据え置き、年間配当予想は26円50銭としております。

今後は、既存事業の収益力強化を進めるとともに、大英エレクトロニクス株式会社との連携の進捗、半導体関連マスクの受注・生産動向、国内印刷事業の採算改善の状況、海外事業の収益動向を継続的に確認し、業績の進捗及び投資の成果を検証してまいります。

業績予想等は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は、需要動向、原材料価格、為替相場及び金利等の変動により、予想と異なる結果となる可能性があります。今後、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,282	5,410
受取手形及び売掛金	5,305	4,978
電子記録債権	1,732	1,419
有価証券	100	－
商品及び製品	665	744
仕掛品	404	693
原材料及び貯蔵品	474	604
その他	791	696
貸倒引当金	△70	△84
流動資産合計	15,686	14,462
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,756	4,630
機械装置及び運搬具（純額）	1,272	1,435
土地	5,925	7,904
リース資産（純額）	1,341	1,859
建設仮勘定	1,197	1,506
その他（純額）	416	400
有形固定資産合計	13,909	17,736
無形固定資産		
のれん	－	1,502
その他	646	684
無形固定資産合計	646	2,186
投資その他の資産		
投資有価証券	3,647	3,900
繰延税金資産	180	159
その他	728	723
貸倒引当金	△144	△145
投資その他の資産合計	4,411	4,637
固定資産合計	18,968	24,561
資産合計	34,654	39,023

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （2026年３月31日）	当中間連結会計期間 （2026年９月30日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,845	2,407
電子記録債務	2,855	2,643
短期借入金	730	5,419
１年内返済予定の長期借入金	593	589
リース債務	345	364
未払法人税等	237	403
賞与引当金	589	530
その他の引当金	71	20
その他	1,754	1,052
流動負債合計	10,022	13,430
固定負債		
長期借入金	670	527
リース債務	1,103	1,597
長期未払金	138	148
退職給付に係る負債	1,601	1,715
資産除去債務	235	238
役員退職慰労引当金	－	31
その他	883	921
固定負債合計	4,633	5,180
負債合計	14,655	18,611
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,937	1,937
資本剰余金	1,809	1,840
利益剰余金	13,830	14,211
自己株式	△305	△618
株主資本合計	17,272	17,370
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,746	2,038
為替換算調整勘定	514	573
退職給付に係る調整累計額	324	290
その他の包括利益累計額合計	2,584	2,901
非支配株主持分	141	140
純資産合計	19,998	20,412
負債純資産合計	34,654	39,023

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

（中間連結損益計算書）

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
売上高	15,903	17,041
売上原価	12,465	13,237
売上総利益	3,438	3,803
販売費及び一般管理費	2,985	3,230
営業利益	453	572
営業外収益		
受取配当金	48	55
貸倒引当金戻入額	4	12
為替差益	11	－
その他	16	27
営業外収益合計	80	95
営業外費用		
支払利息	15	58
投資事業組合運用損	2	2
為替差損	―	19
その他	4	5
営業外費用合計	22	85
経常利益	510	582
特別利益		
固定資産売却益	90	32
投資有価証券売却益	49	508
その他	―	2
特別利益合計	139	542
特別損失		
固定資産処分損	5	59
投資有価証券売却損	0	0
会員権評価損	―	30
その他	0	2
特別損失合計	6	92
税金等調整前中間純利益	643	1,032
法人税等	215	374
中間純利益	427	657
非支配株主に帰属する中間純利益	0	0
親会社株主に帰属する中間純利益	427	656

（中間連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
中間純利益	427	657
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	331	291
為替換算調整勘定	△135	59
退職給付に係る調整額	△22	△34
その他の包括利益合計	173	316
中間包括利益	601	973
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	601	973
非支配株主に係る中間包括利益	0	0

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2026年４月１日 至　2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益	643	1,032
減価償却費	445	610
のれん償却額	－	79
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	△89	△79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△52	△40
受取利息及び受取配当金	△55	△61
支払利息	15	58
投資有価証券売却損益（△は益）	△48	△507
固定資産除売却損益（△は益）	△84	27
会員権評価損	－	30
売上債権の増減額（△は増加）	401	770
棚卸資産の増減額（△は増加）	△137	△488
前渡金の増減額（△は増加）	△598	△40
仕入債務の増減額（△は減少）	147	△650
未払消費税等の増減額（△は減少）	△131	37
その他	△131	94
小計	331	884
利息及び配当金の受取額	55	61
利息の支払額	△14	△63
法人税等の支払額	△195	△214
営業活動によるキャッシュ・フロー	176	668
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	－	50
固定資産の取得による支出	△1,165	△4,272
固定資産の売却による収入	91	210
投資有価証券の取得による支出	△11	△11
有価証券の償還による収入	－	100
投資有価証券の売却及び償還による収入	80	680
貸付けによる支出	－	△2
貸付金の回収による収入	0	0
差入保証金の差入による支出	△2	△11
差入保証金の回収による収入	17	25
保険積立金の解約による収入	31	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,040
その他	0	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△957	△5,272
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	4,689
長期借入れによる収入	400	－
長期借入金の返済による支出	△144	△148
リース債務の返済による支出	△150	△198
自己株式の取得による支出	－	△337
配当金の支払額	△224	△275
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
その他	△2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△123	3,727
現金及び現金同等物に係る換算差額	△62	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△967	△841
現金及び現金同等物の期首残高	6,686	5,935
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,718	5,094

（４）中間連結財務諸表に関する注記事項

（中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記）

（連結の範囲の重要な変更）

当中間連結会計期間より、大英エレクトロニクス株式会社の株式を取得したため、同社を連結の範囲に含めております。

なお、当該連結範囲の変更は、当中間連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えることが見込まれます。その影響の概要は、連結貸借対照表の総資産の増加、連結損益計算書の売上高等の増加であります。

（セグメント情報等の注記）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	報告セグメント				計	調整額（注）１	中間連結損益計算書計上額（注）２
	情報コミュニケーション	ソリューションセールス	半導体関連マスク	不動産賃貸			
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	7,439	5,444	2,980	39	15,903	－	15,903
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	15	912	－	350	1,279	△1,279	－
計	7,455	6,356	2,980	390	17,182	△1,279	15,903
セグメント利益	28	154	276	210	669	△216	453

（注）１．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去及び各事業セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産にかかる重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2026年４月１日　至　2026年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	報告セグメント				計	調整額（注）１	中間連結損益計算書計上額（注）２
	情報コミュニケーション	ソリューションセールス	半導体関連マスク	不動産賃貸			
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	7,511	5,763	3,725	39	17,041	－	17,041
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	17	207	－	316	540	△540	－
計	7,528	5,971	3,725	356	17,582	△540	17,041
セグメント利益	35	160	388	207	791	△218	572

（注）１．セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去及び各事業セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産にかかる重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

「半導体関連マスク」セグメントにおいて、大英エレクトロニクス株式会社の株式取得により、1,581百万円ののれんが発生しました。なお、当中間連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、当該金額は暫定的に算定しております。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

当社は2026年６月17日開催の取締役会において、ムトー精工株式会社から、同社の子会社である大英エレクトロニクス株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、2026年６月17日付で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式譲渡契約に基づき、当社は2026年７月13日付で株式を取得しております。

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称：大英エレクトロニクス株式会社

事業の内容：プリント基板回路設計、基板電気検査、３Ｄ－ＭＩＤ設計サービス

（２）企業結合を行った主な理由

当社グループは、印刷事業を祖業とし、現在では情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスク、不動産賃貸等の事業を展開しております。当社グループの半導体関連マスク事業は、当社（旧竹田印刷株式会社）において、製版技術を応用した新規事業として1987年に開始しました。その後、Ｍ＆Ａ等を通じて事業規模を拡大し、現在では、事業会社である竹田東京プロセスサービス株式会社及び株式会社プロセス・ラボ・ミクロンを中核として、グループの重要な事業セグメントへと成長しております。現在は、電子部品向け精密工業用写真製版（スクリーンマスク、フォトマスク）及び電子部品実装用各種マスクの製造・販売、ならびにこれらに付随する業務を展開しており、中国、タイ及びベトナムへと事業展開を進め、当社グループの成長分野として、さらなる事業領域の拡大を図っております。

大英エレクトロニクス株式会社は、プリント配線板の基板設計及びプリント配線板等の検査サービスを主たる事業としております。設計部門においては、経験豊富な設計者が多数在籍し、設計ノウハウが 組織として蓄積・共有されていることから、高い設計対応力を有しております。また、検査サービスについても、プリント配線板等に関する知見及び顧客基盤を有しており、当社グループの半導体関連マスク事業との親和性が高いものと認識しております。

本件株式取得により、大英エレクトロニクス株式会社の設計・検査に関する人材、技術及びノウハウと、当社グループが有する製造技術、設計・製造ノウハウ並びに国内外の顧客基盤を組み合わせることで、基板設計からマスク製造・検査に至る提案力の強化、顧客ニーズへの対応力向上、及び当社グループが製造・販売するフォトマスク、スクリーンマスク等の受注機会の拡大が期待できるものと考えております。

また、当社グループと大英エレクトロニクス株式会社は共通する顧客基盤を有していることから、既存顧客に対する提案領域の拡大と取引関係の一層の深化が可能と考えております。

このように、当社グループの半導体関連マスク事業と大英エレクトロニクス株式会社の事業は、技術領域・顧客領域の両面で重なりが大きく、高い親和性を有していることから、相互にシナジーを発揮することができ、より持続的かつ安定的な成長を図ることが可能であると考えており、本件株式取得は、当社グループの事業領域の拡大及び企業価値の向上に資するものと判断いたしました。

（３）企業結合日

2026年７月13日（株式取得日）

2026年６月30日（みなし取得日）

（４）企業結合の法的形式

現金を対価とする株式の取得

（５）結合後企業の名称

名称の変更はありません。

（６）取得した議決権比率

100%

大英エレクトロニクス株式会社の発行済株式数160,000株のうち、自己株式3,560株を除いた156,440株を当社が取得し同社を100%子会社といたしました。

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

２．中間連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2026年７月１日から2026年９月30日まで

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　現金	2,289百万円
取得原価	2,289百万円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　16百万円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（１）発生したのれんの金額

1,581百万円

なお、のれんの金額は、当中間連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

（２）発生原因

主として、今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

（３）償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	377　百万円
固定資産	559
資産合計	937
流動負債	96
固定負債	134
負債合計	230

７．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高　217百万円

営業利益　11

経常利益　12

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。当該概算額には企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとし、償却額の調整を行い算出しております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（本店移転）

当社は2026年11月13日開催の取締役会において、本店（本社）を移転することを決議いたしました。本店（本社）移転の概要につきましては以下のとおりです。

（１）移転先（新本店所在地）

愛知県名古屋市中区金山五丁目２番１号

（ご参考 現本店所在地：愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号）

（２）移転時期

2027年５月予定

（３）移転の理由

当社グループの連携強化及び業務効率の向上を図るとともに、従業員の働きやすい職場環境を整備し、持続的な企業価値向上につなげるため、本店（本社）を移転することといたしました。

（４）業績に与える影響

本店（本社）移転実施に伴う費用については精査中であります。

（５）その他

同一市内（名古屋市）の本店移転であるため、定款上の本店所在地の変更はありません。